

王裕銘 個人履歷表

***現職：**工業技術研究院 機械與機電系統研究所 企劃研發組 組長 正研究員

***學歷：**

國別	學校名稱	系所	學位	起迄年月(西元)
中華民國	臺灣大學	應用力學	博士	2002.06~2006.09
中華民國	清華大學	動力機械	碩士	2000.09~2002.06

***主要經歷：**

服務機關	服務部門	職稱	起迄年月(西元)
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	企劃研發組	組長	111.02~迄今
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	半導體設備技術組	組長	109.01~111.01
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	先進製造技術組	副組長	108.3~108.12
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	先進製造技術組	研發副組長	107.01~108.2
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	印刷電子設備部	經理	104.01~106.12
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	微奈米製造技術部	副經理	101.06~103.12
工業技術研究院/機械與機電系統研究所	微奈米製造技術部	研究員	100.03~101.06

***專長：**

應用力學、動力機械

重要成就：

1. 嘉聯益科技-建立「全球首創卷對卷全加成軟板量產線」
2. 黑木公司-促成新創事業體，建立台灣第一家印刷電子代工公司
3. 李長榮化工、誠霸科技、恆橋產業-建立國內加成式印刷電子零組件供應體系，建構國內自主研發能量
4. 廣達、宏業、連展、霖昱、盛聚-建構高頻軟性傳輸線於次世代5G行動通訊

王裕銘 個人履歷表

5. 日本郡是公司-佈局次世代基板及感測元件應用
6. 映利科技-促成「人工智慧化電路板複檢技術及設備」之新創公司成立
7. 妙印精機-協助國內網印設備廠商進行設備智慧升級

獲獎事蹟：

1. 2021年榮獲 工研院產業化貢獻金牌獎
2. 2021年榮獲 工研院傑出研究金牌獎
3. 2020年榮獲 工研院產業化貢獻銀牌獎
4. 2019年中華民國科技管理學會 科技管理獎
5. 2019年榮獲 經濟部技術處 法人科專技術成就獎
6. 2019年榮獲 經濟部國家產業創新獎(團隊創新領航)
7. 2018年榮獲 經濟部智慧財產局 國家發明創作銀牌獎
8. 2017年榮獲 產業化貢獻金牌獎
9. 2016年榮獲 中國工程師學會「優秀青年工程師獎」
10. 2014年榮獲 傑出研究獎銀牌獎
11. 2013年榮獲 傑出研究獎銅牌獎

著作論文：SCI論文3篇、國內論文10篇

專利：中華民國 14 件、美國 5 件、日本 2 件、德國 1 件、中國 6 件